

LDS工法 MID対応 無電解銅めっきプロセス

トップMICプロセス

Electroless Copper Plating Process for MID with LDS

TOP MIC PROCESS

- レーザー加工部へのめっき析出性およびパターン性に優れる
 - 電気めっきをするための導電層を一段めっきで形成可能
 - 各種最終表面処理にも適応できる
- Great deposition- and fine patterning performances to LDS parts
 - Can form conductive layers for electroplating by one-time plating
 - Applicable to final surface treatments

処理工程 Process

脱脂
Cleaning

OPCクリーナーMIC
OPC CLEANER MIC

薄付け無電解銅めっき
Thin electroless copper plating

OPC銅MIC-ST
OPC COPPER MIC-ST

レーザー加工部に
選択的にめっき析出
Great deposition selectivity
to LDS parts

幅広い
レーザー条件に対応
Applicable to
wide laser conditions

厚付け無電解銅めっき
Thick electroless copper plating

OPC銅MIC-BL
OPC COPPER MIC-BL

高い析出速度
パターン選択性を両立
High deposition rate,
great patterning selectivity
come available together

55°C 5μm/h

各種最終表面処理に適応(無電解ニッケル/金, 銀) Applicable to various final surface treatments like electroless Ni/Au, electroless Ni/Ag

無電解ニッケルめっき ICPニコロンLTN(NP)
Electroless nickel plating ICP NICORON LTN (NP)

無電解金めっき ムデンノーブルAU
Electroless gold plating MU DEN NOBLE AU

無電解銀めっき ムデンシルバーSS
Electroless silver plating MU DEN SILVER SS

無電解金、銀仕上げ
Final treatment:
electroless Au, electroless Ag

65°C
5μm/35min

50°C
0.05μm/5min

75°C
0.2μm/15min

めっき例 無電解銅/ニッケル/金 Example Electroless Cu/Ni/Au

